



飯統戴老板：中國芯片往事

感謝原作者創作，目前看過最詳細的芯片發展歷史。一家之談可做參考。從艱難萌芽到全面對決，中國芯片行業的跌宕起伏六十年



張汝京

上個世紀三十年代，河北籍學生張錫綸從中國第一所礦業高等學府焦作工學院畢業，作為一名專業為冶煉學的稀缺人才，他被上海的一家煉鋼廠錄用。抗戰爆發後，上海工業大規模西遷，張錫綸也隨着大部隊輾轉來到了戰時陪都重慶。他工作的煉鋼廠被並入國民政府軍事工業系統，成為隸屬兵工署的第21兵工廠。

1945年抗戰勝利後，兵工署派遣大量人員奔赴全國，接管侵華日軍遺留下的軍械廠。張錫綸也隨同事來到南京，接收位于雨花台附近的日本野戰造兵廠，並在此建立了兵工署第60兵工廠。此時的張錫綸已經是業內有名的煉鋼專家，他在南京立業安家，與相識多年的女友成婚，1948年，他的第二個孩子出生，取名張汝京。

淮海戰役結束之後，解放軍兵鋒逼近長江，粟裕的三野第八兵團已經隔江駐紮在南京對岸，第60兵工廠開始緊急撤往台灣。已經是國軍上校長官的張錫綸，自知絕對不能留在大陸，於是和家人帶着尚在襁褓之中的張汝京，跟隨着遷廠的大部隊，于1949年初的一個鉛雲密布的清晨，在南京下關登船，啓程前往台灣高雄。

除了自己的一大家子人之外，張錫綸還帶走了兵工廠里兩百多位年輕的冶金學徒。在啓程前，不少學徒的父母如托孤一般懇求張錫綸，請求他照顧好孩子。在這之後的幾十年里，張錫綸一直做到兵工廠資深高層，同時也像大家長一般照顧着兩百多位年輕人，幫他們就學成家立業，這些年輕的孩子長大後結婚，張錫綸永遠都是證婚人。

不滿一歲就被帶到台灣的張汝京，長大後讀書成績優異，一路考上台灣大學，並之後前往美國留學，先後取得工程學碩士和電子學博士的學位。1977年，29歲的張汝京入職美國半導體巨頭德州儀器，並加入諾貝爾物理學獎獲得者、集成電路的發明人杰克·基爾比(Jack Kilby)的團隊。在德州儀器，張汝京從研發設計工程師做起，一干就是二十年。

從60年代開始，華人就在美國半導體行業嶄露頭角，天才工程師和卓越企業家不斷涌現。張汝京在德州儀器的頂頭上司邵子凡博士，就是全球最頂級的芯片製造工廠建設專家。在邵子凡的提攜和栽培下，張汝京迅速成長，前後參與了9個大型芯片廠的建設，遍布美國、日本、新加坡、意大利等地，成為業內公認的“建廠高手”。

由於張汝京的事業重心落在美國，張錫綸和妻子劉佩金在退休之後均搬到美國居住。跟無數從大陸撤至台灣的老一輩一樣，張錫綸夫婦也是家國情結極重的人，時刻牽挂着祖國大陸。在張汝京事業蒸蒸日上，成為全球芯片行業知名的建廠專家之後，張錫綸問了兒子這樣一個問題：“你什麼時候去大陸建廠？”

父親的問題，在90年代末迎來瞭解答的契機。1997年，在德州儀器工作了20年之後，張汝京提前退休。經過一段短暫的大陸行之後(後文會提及)，他在老朋友的支持下回到台灣擔任了世大半導體，並迅速做到量產和盈利。在此期間，張汝京已經做好了在大陸建設芯片工廠的詳細計劃：世大第一廠和第二廠建在台灣，第三廠到第十廠全部放在大陸。

世事難料，迅速崛起的世大引起了行業龍頭台積電的警惕。就在張汝京準備大干一場的時候，世大的大股東在張汝京毫不知情的情況下，與台積電秘密商討，在2000年1月將公司作價50億美金賣給了台積電。張汝京事後才知曉此事，自知在合併後的新公司里難有立足之地，於是毫不拖泥帶水，在收購完成後的第二天便辭職，決定北上大陸再次創業。

憑藉着業內的名氣和世大的成功經驗，張汝京迅速聚攏起一批人才和資金，並開始着手選擇廠址。2000年那會的芯片行業，遠不如現在這般炙手可熱。不過在上海，他們受到了熱情接待，時任市長徐匡迪親自出馬，帶他們來到遍布農田的浦東腹地，向張汝京展示了上海為他們規劃建廠的大片土地。

2001年4月，在這個叫做張江高科的地方，張汝京的新工廠中芯國際成立了。在之後很長一段時間內，這兩個名字在中國半導體行業佔據極重的分量。

1949年，張錫綸帶着200名冶金學徒，從

南京撤至高雄，建立了規模龐大的高雄六〇兵工廠；2000年，張汝京帶領300名芯片工程師，從台北來到上海，建立了大陸最先進的芯片製造基地。

歷史在張家父子兩代人之間，完成了一個輪回，但張汝京和中芯國際的艱難歷程，以及背後中國半導體產業的芯酸往事，才剛剛拉開帷幕。

1

在張汝京回到大陸成立中芯國際之前，中國的半導體行業已經踽踽獨行了接近半個世紀之久，院所教授、政府官員、海歸精英、資本掮客等一大批人物逐一登上歷史舞臺。為理清這些錯綜複雜的歷史，我將時間線索按照行業的主導力量來劃分，大致可以分成四個階段：

堅強萌芽：

計劃機制中的專家主導(1956-1978年)

混亂年代：

外部衝擊導致行業失序(1978-2000年)

西雁東飛：

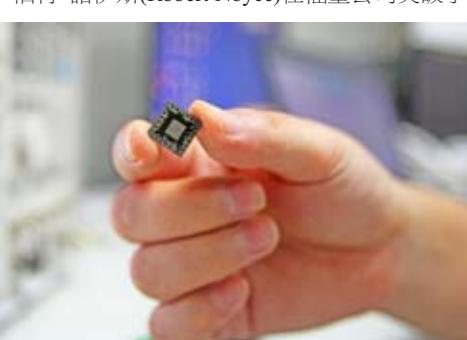
海歸創業潮與民企崛起(2000-2015年)

全面對決：

國資入場打響芯片戰爭(2015-2018年)

中國第一批走入中國芯片發展史的是蘇聯式軍事工業和科研體系內的院所專家們，他們從50年代開始建設中國的半導體技術和工業體系，可以總結為一句話：用蘇聯的體系和中國的人才，來追美國的影子。

說是追美國的影子並不為過，集成電路行業本身就是誕生於上世紀50年代的美國。1958年9月12日，張汝京日後的上司杰克·基爾比(Jack Kilby)在德州儀器研製出世界上第一塊集成電路，成功地實現了把電子器件集成在一塊半導體材料上的構想。1959年7月，羅伯特·諾伊斯(Robert Noyce)在仙童公司突破了



集成電路的平面製作工藝，為大規模工業量產奠定了基礎。

基爾比和諾伊斯被並成為集成電路的發明者，在他們大放異彩的年代，中國人正在經歷“大躍進”和“三年自然災害”，而這時大洋彼岸的硅谷已經顯露雛形，仙童、Intel、AMD等大批公司相繼在50-60年代成立。與美國對應的是，中國在1960年成立了以中科院半導體所為代表的大批研究機構，並在全國建設數十個電子廠，初步搭建了中國半導體工業的“研發+生產”體系。

這套體系最初能夠緊追美國，得益於一批回到新中國的半導體人才，如黃昆、謝希德、王守武、高鼎三、吳錫九、林蘭英、黃敞等前輩大師。在他們的帶領下，蹒跚起步的中國半導體行業做了兩大貢獻：一是保障了“兩彈一星”等一批重大軍事項目的電子和計算配套；二是為中國建立了一套橫跨院所和高校的半導體人才培養體系。

但在產業化方面，成就卻寥寥可數。1977年7月，鄧小平邀請30位科技界代表在人民大會堂召開座談會，半導體學界靈魂人物王守武發言說：“全國共有600多家半導體生產工廠，其一年生產的集成電路總量，只等於日本一家大型工廠月產量的十分之一。”一句話就把改開之前中國半導體行業成就和底蘊概括得八九不離十。

但能取得這樣的成績，已屬難得。王守武是美國普渡大學畢業的高材生，文革中被停職批鬥，備受誣謗和誹謗；中國半導體物理的奠基人謝希德，被整成走資派後，每天工作是掃廁所；而拉出中國第一根硅單晶棒的林蘭英，父親因為做過國民黨的縣黨部書記，被造反派在火車上毆打致死，林蘭英自己也受屈辱。

幾十年後回顧這段歷史，總是有人試圖用一句“無私奉獻”將他們的這些經歷一筆帶過，並喜歡大聲質問芯片從業人員：你們為何不效仿前輩們捨身忘我的啃乾糧精神？

2

改革開放之後，打開國門的中國人猛然發現，美日的半導體產業也已經將中國遠拋身後，差距在10年以上，韓台也在迅速超過中國。但除了少數專家外，上至廟堂高管，下至平民百姓，國人對這種差距和追趕的難度普遍認識不足，比如在1977年，總設計師問王守武：“你們一定要把大規模集成電路搞上去，一年行嗎？”

領導的殷切關懷，催生了中國獨特的產學研模式：通過運動式的集中攻關，來突破某項技術。這種方式在不考慮成本和效率的軍工領域內是有效的，如兩彈一星，但在產業化和民用化方面，基本上是死路一條。時至今日，中國集成電路學界領很多“達到國際水平”的成果，只具備“展示和驗收”功能：一經專家評審會通過，就束之高閣生銹落灰，極少走向市場。

改革開放之後，包括半導體在內的中國電子產業開始受到猛烈的外部衝擊。由於大量國營電子企業經營困難，無法產生足夠的利潤來支撐研發，從國外引進的生產線又大多是落後淘汰的二手貨。所以在80年代，中國半導體行業不僅大幅落後於美日，也逐漸被韓國和台灣地區超過。為解決這種情況，國家部委先後組織了三大“戰役”，分別是：

1986年的“531戰略”

1990年的“908工程”

1995年的“909工程”

531戰略是在1986年針對“七五”提出的，即“普及5微米技術、研發3微米技術，攻關1微米技術”，並在全國多點開花建設集成電路製造基地。從1986年到1995年，陸續誕生了無錫華晶、紹興華越、上海貝嶺、上海飛利浦、和首鋼NEC等五家公司。這裏面最具代表性的，當屬首鋼NEC的誕生和失敗。

首鋼涉足芯片製造是在1991年，那會兒的首鋼是北京的牛逼單位，財大氣粗不差錢，掌門人周冠五更是連中央領導都不放眼里。1991年12月，首鋼喊出了“首鋼未來不姓鋼”的口號，跨界芯片，與NEC成立合資公司，技術全部來自于NEC，工廠“對着日本圖紙生產”。儘管NEC提供的技術不算先進，但恰逢行業景氣，1995年的銷售額就達到了9個多億。

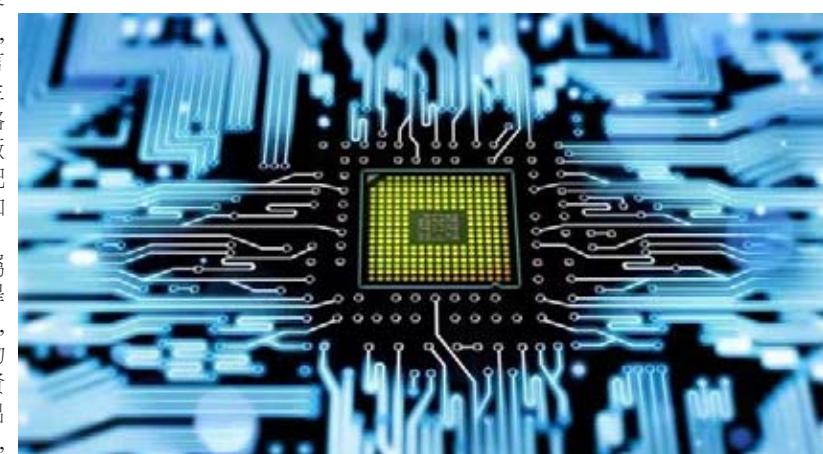
受此激勵，首鋼準備再接再厲。2000年12月，首鋼找了一家美國公司AOS，合資成立“華夏半導體”，投資13億美金做8英寸芯片，技術來源于AOS。但很快，2001年IT泡沫導致全球芯片行業低迷，AOS跑得比兔子還快，華夏半導體沒了技術來源，很快夭折，而與NEC的合資公司也陷入虧損。2004年，首鋼基本退出芯片行業。

這是大型企業受地方政府“鼓勵”跨界做芯片的第一個案例，未來還會不斷重演。據說首鋼當年規劃的轉型方向只有地產做的還不錯，這種強烈對比蘊含的道理，足夠很長時間來玩味和琢磨。

面對越拉越大的差距，1990年9月電子工業部又決定啓動“908工程”，想在超大規模集成電路方面有所突破，目標是建成一條6英寸0.8~1.2微米的芯片生產線。項目由無錫華晶承擔，芯片技術則向美國朗訊購買，但最終結果是：行政審批花了2年，技術引進花了3年，建廠施工花了2年，總共7年時間，投產即落後，月產量也僅有800片。

嚴重虧損的華晶只能尋求外部幫助。曾經創辦茂矽電子的台灣人陳正宇當時正在尋找機遇，便與華晶談判，拿下了委託管理的合同。為了改造華晶，陳正宇求助于老朋友張汝京。張汝京當時剛從德州儀器退休，他來到無錫後，僅用了半年時間(1998年2月-8月)就完成任務，改造後的華晶于1999年5月達到盈虧平衡，項目才得以驗收。

沒有達到預期效果的“908工程”，使中國



半導體又浪費了5年的寶貴時間。在無錫華晶還卡在0.8微米無法量產時，海外主流制程已經達到了0.18微米，差距呈現越來越大的趨勢。1995年，電子工業部又提出實施“909工程”，投資100億人民幣，由上海華虹承擔，與NEC合作，電子工業部部長胡啟立親自挂帥。在萬眾矚目下，建國以來最大的電子工業項目於1996年啓動了。

近些年習慣了強國語境的年輕人，很難想像上世紀90年代中國人面對與發達國家的恐怖差距時的那種絕望。“909工程”在國家領導人“砸鍋賣鐵”的批復下啓動，頂着巨大壓力背水

一戰，克服了華晶七年建廠的悲劇，于1997年7月開工，1999年2月完工，用了不到兩年即建成試產，在2000年就取得了30億銷售，5.16億的利潤。

到了2001年，華虹NEC也遭遇了芯片行業的寒冬，全年虧損13.84億，這時批評又紛至沓來，無數媒體指責“光靠砸錢做不起芯片”。這時候的中國，幾乎沒有人知道三星越虧越投的“反周期大法”，更沒有人瞭解張汝京的“蓋廠一定要在行業低潮期”的理論，因此儘管華虹在2004年之後便恢復業績穩定，但在之後的十多年，再也未能獲得國家資金支持擴建陞級。

總結從1978年到2000年的歷史：早期缺乏統一規劃，蜂擁引進國外淘汰的生產線，但這些設備在摩爾定律的驅動下，以超乎尋常的速度變成廢鐵；後期國家出面組織三大戰役，屢敗屢戰，最終通過“909工程”為大陸留下了一座勉強算合格的上海華虹。平心而論，這個階段中國與海外水平的差距，並沒有顯著縮小。

這些項目未能取得預想中的成功，深層次的原因有兩個：一是芯片行業更新速度太快，制程陞級一日千里，國內八九十年代這種沒有連貫性的“擠牙膏”式投入，必然會陷入“引進-建廠-投產-落後-再引進”的惡性循環，效果很差；二是半導體相關人才實在是太弱，根本無法吃透引進來的技術，遑論自主研發。

另外，西方國家先後用“巴統”和“瓦森納協議”來限制向中國出口最先進的高科技設備，同意批准出口的技術通常比最先進的晚兩代，加上中間拖延和落地消化，基本上中國拿到手的技術就差不多落後三代左右。這種限制在上述重大工程中都得到了充分體現。

人才問題，率先在2000年左右迎來了轉機，大批有海外留學經驗、在頂級芯片公司工作多年的半導體人才，在這一時期回到中國。

在西雁東飛的回歸潮中，中星微的鄧中翰于1999年回國，中芯的張汝京于2000年回國，展訊的武平和陳大同于2001年回國，芯原的戴偉民于2002年回國，兆易的朱一明于2004年回國，他們帶着豐富的經驗和珍貴的火種，跳進了中國半導體行業的歷史進程之中。

2000年之後，中國芯片行業進入了海歸創業和民企崛起的時代。

3

在講述海歸和民企的時代之前，先跟讀者普及一個中國芯片行業有趣的迷思：大多數優秀的中國芯片公司，都成立于2000年之後的幾年。其中包括：

中芯國際成立於2000年；

珠海炬力成立於2001年；

展訊通信成立於2001年；

福建瑞芯成立於2001年；

匯頂科技成立於2002年；

銳迪科成立於2002年；

中興微成立於2003年；

華為海思成立於2004年；

瀾起科技成立於2004年；

兆易創新成立於2004年。

這裏面的背景就是：中國改革開放初期培養的電子/計算機/通信類理工科學生，在80年代出國潮中率先留洋，畢業後留在美國半導體行業工作，見識和能力都得到了鍛煉。在2000年之後，這批人積攢了足夠多的技術沉淀和管理經驗，開始陸續從大洋彼岸回到中國創業。

半導體行業有一個獨特的特點：人才的培養周期長，就是通常所說的“板凳要坐十年冷”，大多數頂尖人才都必須要讀到博士。這跟互聯網行業截然相反，幾個年輕人聚在一起搗騰一個網站或者App就能融資的現象，在芯片行業幾乎不存在，而行業賺快錢的機會則更是寥寥無幾。

因此，改革開放後培養的理工科人才，首先在計算機、通信和互聯網行業建功立業，促進了騰訊和華為等公司的誕生，但要輪到芯片行業，則還需要等待更多的時間。80-90年代那些畢業的大學生，還不能承擔半導體研發的重擔，他們還需要更多的學習和鍛煉，尤其需要去全球集成電路技術集聚區——美國的硅谷。

這從側面回答了另外一個問題：為何80-90年代中國總是吃不透引進的芯片生產線和技術。原因很簡單：80-90年代承擔芯片研發重任的，應該是60-70年代的大學畢業的中年技術骨幹，但在六七十年代，